

# 半导体

## 看好半导体国产替代穿越周期

证券研究报告

2022年06月07日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号: S1110517070005  
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521050001  
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521110002  
chengruying@tfzq.com

上周(5/30-6/2)行情概览:

上周(5/30-6/2)半导体行情跑赢主要指数。申万半导体行业指数上涨 6.95%，同期创业板指数上涨 5.85%，上证综指上涨 2.08%，深证综指上涨 3.88%，中小板指上涨 4.08%，万得全 A 上涨 3.08%。半导体行业指数跑赢主要指数。

半导体各细分板块整体表现强劲。半导体细分板块中，半导体设备板块上涨 12.6%，IC 设计板块上涨 8.9%，半导体材料板块上涨 6.8%，半导体制造板块上涨 6.0%，分立器件板块上涨 4.9%，封测板块上涨 4.6%。

我们坚定看好半导体全年的结构性行情。此前我们在报告《结构性行情持续，6 大细分赛道值得关注》2022.03.01 中提出“在产能持续紧缺的大背景下，我们持续看好全年板块的结构性行情，汽车电子、服务器芯片、特种 IC、材料设备、晶圆厂、IoT 芯片，6 大细分板块机会值得关注”。

我们复盘了半导体行业周期与经济周期的关系，看好国产替代穿越周期：

- 1) 从总量看，全球半导体市场规模上行带动全球 GDP 总量上升；
- 2) 从增速看，半导体行业整体规模与名义 GDP 增速同频，销售量增速与扣除价格影响的实际 GDP 增速保持同频。
- 3) 从渠道看，半导体销售量在生产端直接通过工业增加值（IVA）促进全球经济增长。
- 4) 从需求端看，半导体增长通过提振消费与投资刺激 GDP 增长。
- 5) 从收入端渠道看，半导体行业规模增大通过刺激就业等渠道间接提振 GDP 增长。
- 6) 分地区看，美国 GDP 周期略有延后，日本 2018 年恢复同频共振。中国集成电路净进口波动与经济周期强相关。中国台湾晶圆制造产值及设备销售额与 GDP 周期相关。

中美贸易冲突背景下，半导体产业链各环节国产替代比率的提升将大幅增加我国半导体产业的供应链安全性，我们重点看好半导体国产替代穿越周期的机会，相关国产半导体厂商有望在全球半导体行业中体现出更强的成长性。

建议关注：

- 1) 半导体材料设备：有研新材/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/拓荆科技/盛美上海；
- 2) IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；
- 3) 晶圆代工：华虹半导体/中芯国际；
- 4) 半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息/圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/普冉股份；

风险提示：宏观不确定性，疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《半导体-行业深度研究:汽车芯片:电动化乘势而行,智能化浪潮之巅》2022-05-26
- 2 《半导体-行业研究周报:半导体估值性价比显现,聚焦 H2 边际向好机会》2022-05-22
- 3 《半导体-行业研究周报:一季度晶圆代工营收再创新高,四月设备招标数据乐观成长趋势明确》2022-05-15

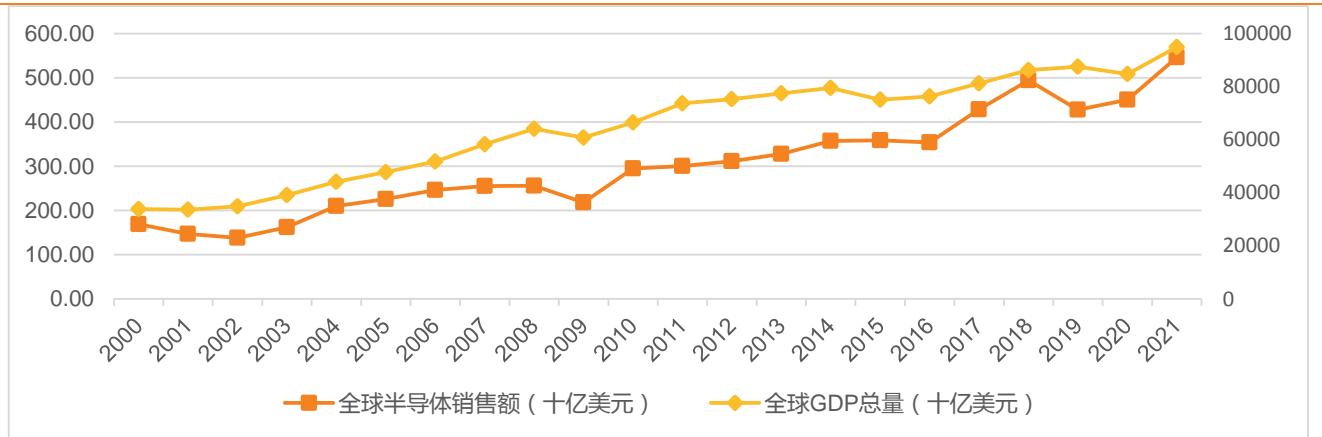
## 内容目录

1. 回顾历史，半导体是 GDP 引擎，与经济周期强相关 .....	3
2. 一周（5/30-6/2）半导体行情回顾 .....	6
3. 重点公司公告 .....	8
4. 半导体重点新闻 .....	9
5. 风险提示： .....	11

## 1. 回顾历史，半导体是 GDP 引擎，与经济周期强相关

从总量看，全球半导体市场规模上行带动全球 GDP 总量上升。根据 SIA 数据，全球半导体的总销售额自 2012 年的 3114 亿美元，上升到 2021 年的 5462 亿美元，CAGR 为 6.44%。全球 GDP 总量自 2012 年 75.31 万亿美元上升了 29% 至 2021 年的 94.94 万亿美元，CAGR 为 2.61%。由此可见半导体增速远远领先全球 GDP 增长，带动整体经济规模不断向上。

图 1：全球半导体销售总量（十亿美元，左轴）与全球 GDP 总量（十亿美元，右轴）



资料来源：Wind，SIA，天风证券研究所

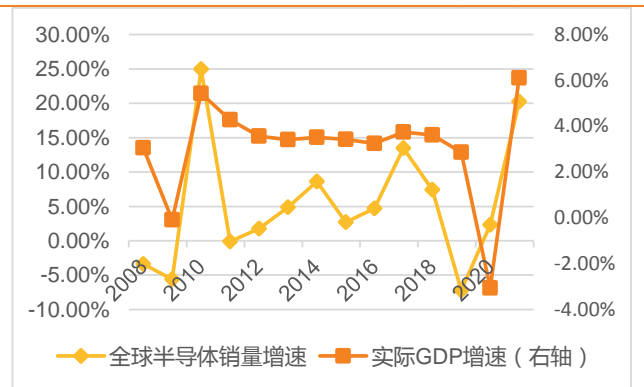
从增速看，半导体行业整体规模与名义 GDP 增速同频，销售量增速与扣除价格影响的实际 GDP 增速保持同频。从全球半导体的销售额和销量同比增速看，半导体行业以 4-6 年左右的时间经历一个上行周期和一个下行周期，上下行周期时长与 GDP 周期基本一致。近年来半导体行业的预警效应更加明显，相较于 GDP 增速半导体行业的增速较有前瞻性，这表明半导体行业的繁荣会明显带动全球经济增长。从增长速度看，半导体销售额增速保持在名义 GDP 增速通常同向变动，半导体销售量增速也与实际 GDP 增速通常同向变动。从时间趋势看，2000-2010 年全球半导体规模及全球经济走势动荡明显，2013 年-2017 年全球半导体市场与经济走势波动相对放缓，2019 年开始波动明显，2020 年全球半导体及 GDP 进入上行周期。

图 2：全球半导体销售额增速与名义 GDP 增速（右轴）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 3：全球半导体销售量增速与实际 GDP 增速（右轴）

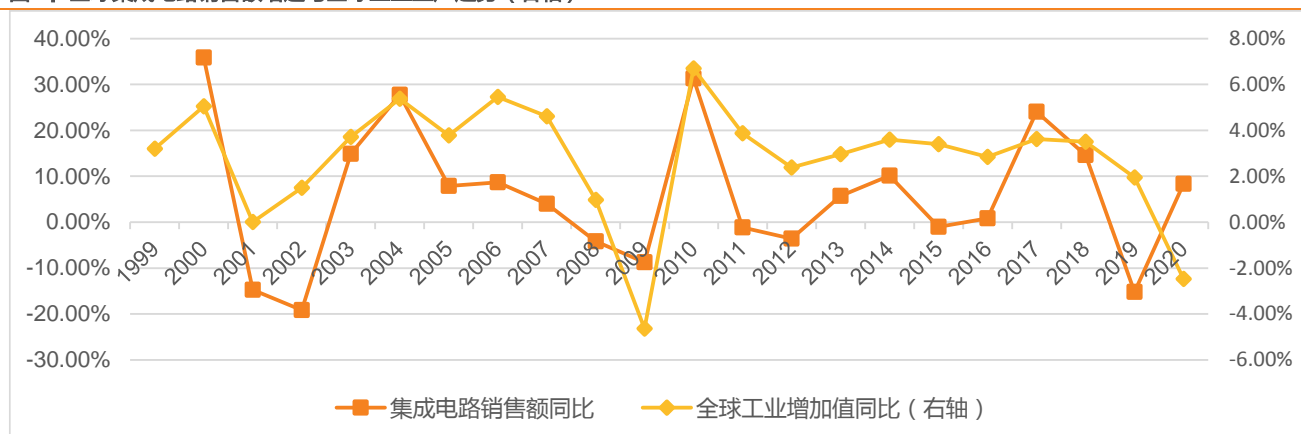


资料来源：Wind，天风证券研究所

从渠道看，半导体销售量在生产端直接通过工业增加值（IVA）促进全球经济增长。全球集成电路销售额增速与全球工业增加值增速趋势基本保持一致。从 GDP 生产端计算方法看， $GDP = \text{第一产业(农业)增加值} + \text{第二产业增加值(工业增加值} + \text{建筑业增加值)} + \text{第三产业增加值}$ 。全球集成电路规模占半导体总规模超 80%，因此集成电路增速基本可以代表全球半导体规模增速。全球集成电路销售额趋势与全球工业增加值增速强挂钩，由此可得半导体行业主要通过对于工业增加值的贡献与 GDP 相关。从增速趋势来看，全球集成电

路销售额增速基本和全球工业增加值同方向变动，拉动全球工业增加值提升。

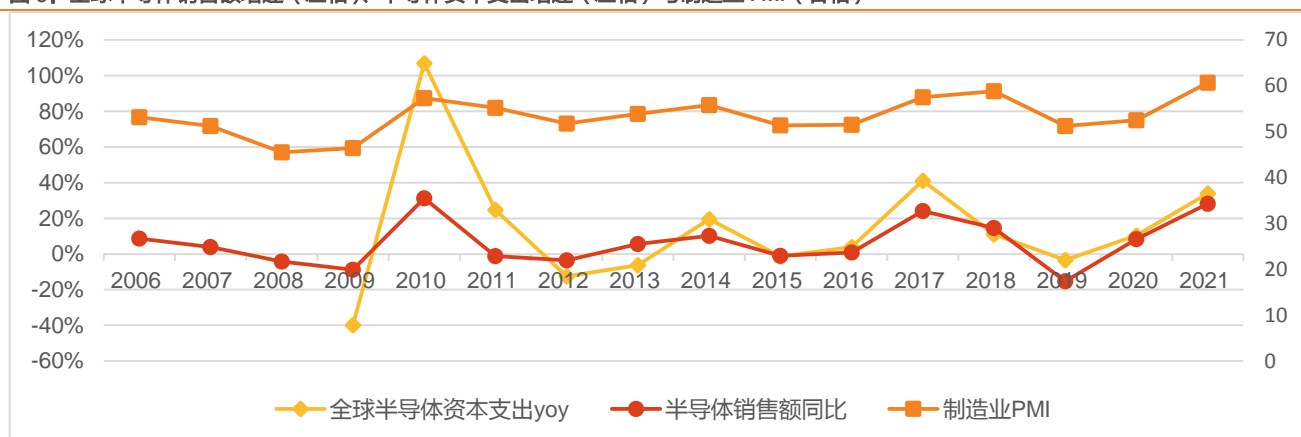
图 4：全球集成电路销售额增速与全球工业生产趋势（右轴）



资料来源：Wind, World Bank, 天风证券研究所

**从需求端看，半导体增长通过提振消费与投资刺激 GDP 增长。**从需求端计算方法看， $GDP = \text{消费} + \text{投资} + \text{政府购买} + \text{净出口}$ ，半导体销售额首先对于消费者支出活动有较强的拉动效应，其次销售额的扩增也通过拉大投资间接拉动 GDP 上行，具有明显的乘数效应。从工业消费拉动看，半导体销售额增速与制造业采购经理指数走势基本一致。从投资看，全球半导体销售额与其资本支出也显示出较强的相关关系，但全球半导体资本支出增速波动性显著强于销售额波动。从历史数据看，PMI 指数在 2010 年、2017 年、2021 年达到较高的水平，于 2021 年达到 60.66。与此相对应的全球半导体资本支出显示出了较强的波动性，2010 年全球半导体资本支出增速超过 100%，2017 及 2021 年资本支出增速分别为 41% 及 36%。资本支出高增长年份通常是市场大幅增长的年份，半导体市场规模增速在 2010 年、2017 年均均为峰值点，随后增速开始放缓。

图 5：全球半导体销售额增速（左轴）、半导体资本支出增速（左轴）与制造业 PMI（右轴）



资料来源：Wind, IC Insights, 天风证券研究所

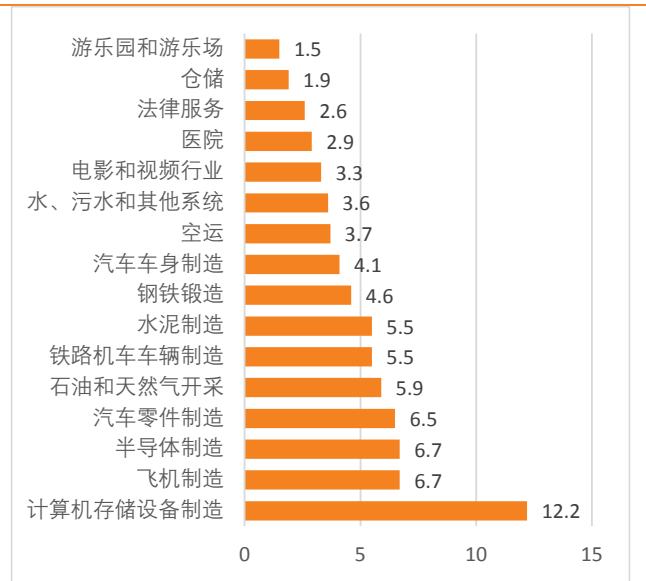
**从收入端渠道看，半导体行业规模增大通过刺激就业等渠道间接提振 GDP 增长。**从计算公式看， $GDP = \text{劳动者报酬} + \text{生产税净额} + \text{固定资本消耗} + \text{营业盈余}$ 。美国半导体销售额与美国制造业 PMI 就业指数波动走势基本一致。根据美国半导体协会与牛津经济研究院联合发布报告，半导体产业对就业具有 6.7 的乘数效应，排在所有 534 个详细行业乘数效应第 85 顺位。所有细分行业乘数效应的中间值为 3.7。其中就业乘数即半导体销售额增长导致了投资或消费支出的变动引起生产和收入的变动，最终导致总就业量对初始就业量增减变化的比率，半导体销售额的提升对就业的驱动不仅通过直接提高半导体相关行业的就业率还通过产业链上的其他间接部门驱动。

图 6：美国半导体销售额增速与美国制造业就业增速



资料来源：Wind，天风证券研究所

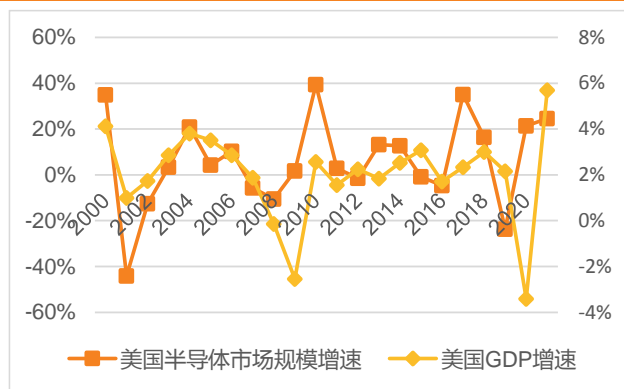
图 7：美国不同行业就业乘数



资料来源：IMPLAN，天风证券研究所

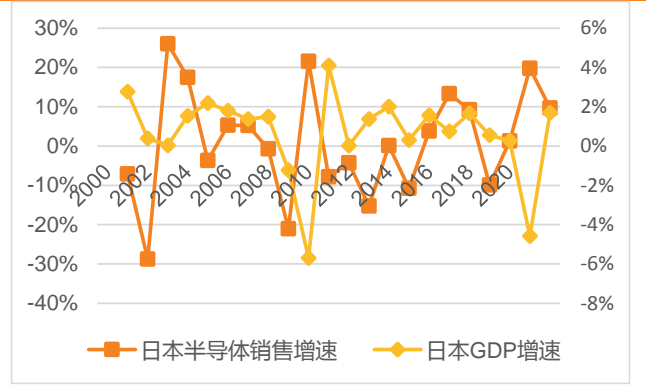
分地区看，美国 GDP 周期略有延后，日本 2018 年恢复同频共振。美国半导体市场规模增速与 GDP 增速基本一致。GDP 周期稍有滞后，半导体作为工业生产的中间产品，更能提早反映经济的波动。日本半导体销售额增速在 2012 年以前，体现了较强的经济周期相关性，2012 年开始与经济周期反向振动，原因是 2012 年金融危机洗礼后的日本的电子产业全线崩溃，包括经历了尔必达破产，瑞萨陷入危机等，2018 年日本半导体产业开始恢复与经济周期同振波动。

图 8：美国半导体市场规模增速与 GDP 增速（右轴）



资料来源：WSTS，天风证券研究所

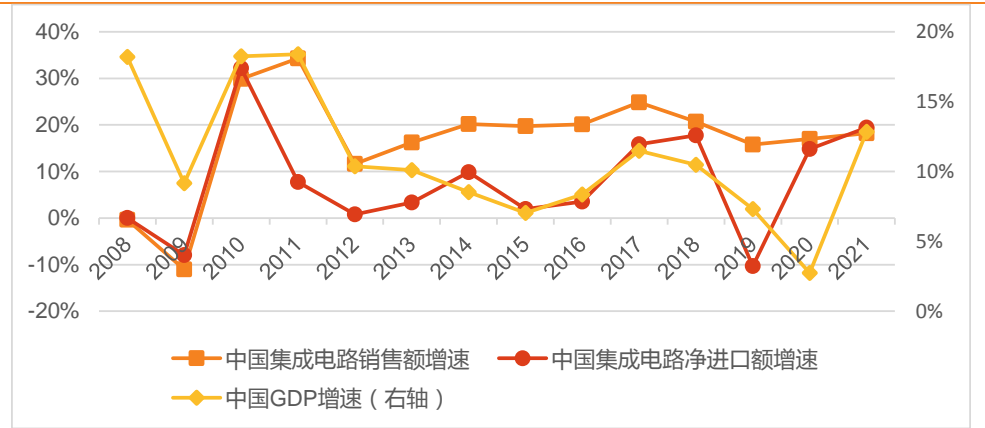
图 9：日本半导体销售额增速与 GDP 增速（右轴）



资料来源：WSTS，天风证券研究所

中国集成电路净进口波动与经济周期强相关。中国集成电路销售额增速、净进口（进口-出口）额均与 GDP 增速显示出强相关关系。2016-2018 年我国集成电路净进口金额增长，2019 年出现下降，2020 年恢复增长，2021 年中国集成电路进口金额累计达 4332 亿美元，净进口额达 2788 亿美元，同比增长 19%。2021 年中国集成电路销售表现良好，创纪录高点，销售额超 10458 亿元，涨幅 18.2%，呈现持续增长的趋势。然而中国集成电路在进口和出口方面仍旧是净流入，对外采购的总量大于对外销售的总额。高端的半导体产品仍旧需从海外进口，国产替代空间仍旧广泛。

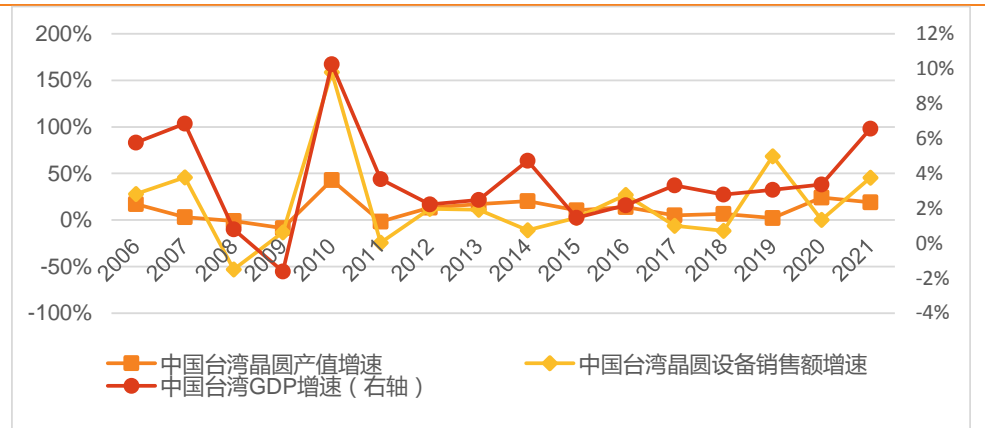
图 10：中国集成电路销售额增速、净进口额增速与 GDP 增速（右轴）



资料来源：Wind,天风证券研究所

中国台湾晶圆制造产值及设备销售额与 GDP 周期相关。中国台湾的经济支柱是半导体、电子代工等制造产业。晶圆设备增速对比晶圆产值增速呈现滞后性，设备交期延长影响其波动趋势。而晶圆产值作为中国台湾地区 GDP 的重要组成部分，直接与中国台湾地区 GDP 波动强相关，拉动中国台湾地区的经济增长。

图 11：台湾地区晶圆产值、晶圆设备销售额增速与 GDP 增速（右轴）



资料来源：Wind,天风证券研究所

## 2. 一周（5/30-6/2）半导体行情回顾

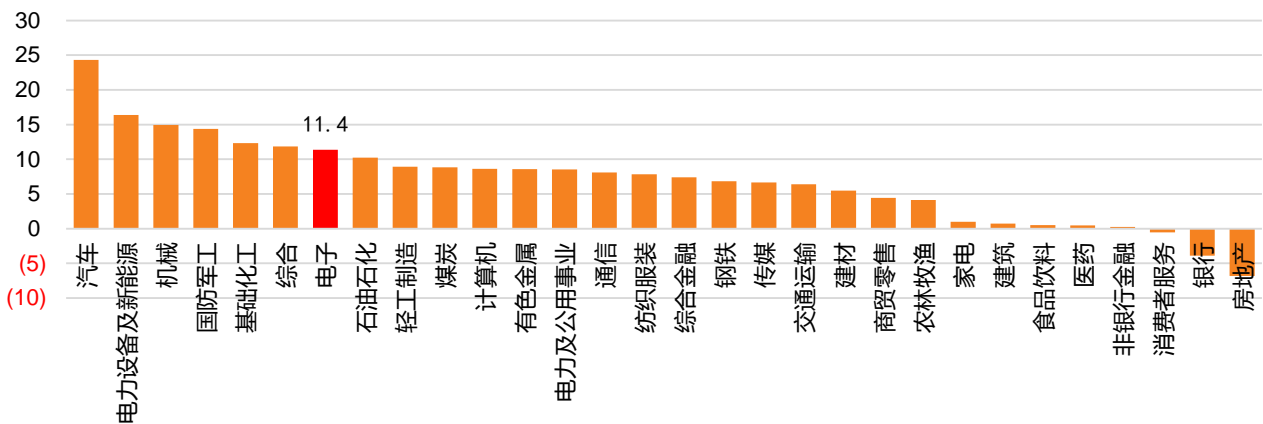
上周（5/30-6/2）半导体行情跑赢主要指数。申万半导体行业指数上涨 6.95%，同期创业板指数上涨 5.85%，上证综指上涨 2.08%，深证综指上涨 3.88%，中小板指上涨 4.08%，万得全 A 上涨 3.08%。半导体行业指数跑赢主要指数。

表 1：一周半导体行情与主要指数对比

	上周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	5.85	1.11
上证综合指数	2.08	4.87
深证综合指数	3.88	3.07
中小板指数	4.08	2.87
万得全 A	3.08	3.87
半导体（申万）	6.95	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

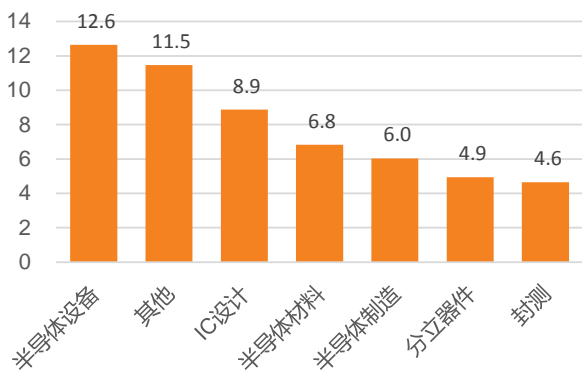
图 12：一周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

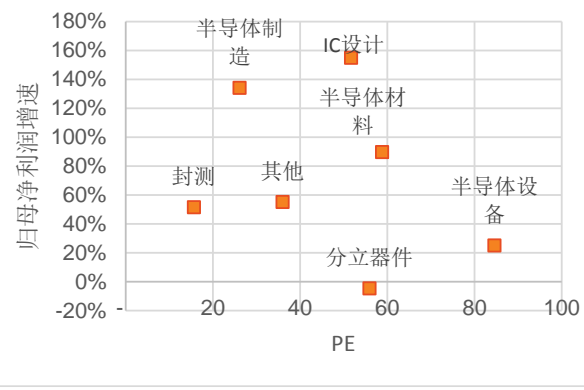
半导体各细分板块整体表现强劲。半导体细分板块中，半导体设备板块上涨 12.6%，IC 设计板块上涨 8.9%，半导体材料板块上涨 6.8%，半导体制造板块上涨 6.0%，分立器件板块上涨 4.9%，封测板块上涨 4.6%。

图 13：上周子版块涨跌幅 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 14：半导体子版块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为：华兴源创、希荻微、恒玄科技、概伦电子、雅克科技、和林微纳、炬芯科技、安路科技-U、芯源微、天岳先进。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为：证通电子、深圳华强、杨杰科技、中颖电子、\*ST 盈方、中环装备、亚翔集成、紫光国微、太极实业、有研新材。

表 2：上周涨跌前 10 半导体个股

上周涨幅前 10	涨跌幅%	上周跌幅前 10	涨跌幅
华兴源创	35%	证通电子	-4%
希荻微	33%	深圳华强	-4%
恒玄科技	31%	杨杰科技	-2%
概伦电子	26%	中颖电子	-1%
雅克科技	24%	*ST 盈方	0%
和林微纳	23%	中环装备	0%
炬芯科技	22%	亚翔集成	1%
安路科技-U	22%	紫光国微	1%
芯源微	21%	太极实业	1%
天岳先进	20%	有研新材	2%

资料来源：Wind，天风证券研究所

### 3. 重点公司公告

#### 【国力股份 688103.SH】

公司于 2022 年 5 月 23 日发布《2022 年限制性股票激励计划》。该激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。拟向激励对象授予限制性股票 149.25 万股，本次限制性股票的授予价格（含预留部分）为 28.00 元/股。首次拟授予的激励对象人数合计 91 人。首次授予的限制性股票对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象当期的归属条件之一。归属条件包括：在 2022 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，达到业绩考核目标：2022 年，公司需满足以下两个目标之一：（1）以 2021 年度营业收入为基数，2022 年度营业收入增长率不低于 30.00%；（2）以 2021 年度净利润为基数，2022 年度净利润增长率不低于 22.00%。2023 年，公司需满足以下两个目标之一：（1）以 2021 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率不低于 69.00%；（2）以 2021 年度净利润为基数，2023 年度净利润增长率不低于 44.00%。2024 年，公司需满足以下两个目标之一：（1）以 2021 年度营业收入为基数，2024 年度营业收入增长率不低于 119.70%；（2）以 2021 年度净利润为基数，2024 年度净利润增长率不低于 72.80%。

#### 【沪硅产业 688126.SH】

公司于 2022 年 5 月 25 日发布《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。公告显示，为抢抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用 300mm 半导体硅片的生产规模。公司拟通过全资子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）出资 155,000 万元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司上海晶昇新诚半导体科技有限公司、二级控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准为准）、三级控股子公司上海新昇晶睿半导体科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准为准），实施 300mm 半导体硅片扩产项目。上海新昇为上述各级子公司的直接/间接控股股东，是扩产项目的主要实施及推进主体。本次对外投资中，公司全资子公司上海新昇拟以货币资金出资 155,000 万元，其中：募集资金出资 150,000 万元、自有资金出资 5,000 万元，其他各合资方拟以货币资金总计出资 524,000 万元。在上海临港建设新增 30 万片集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目，项目包括“集成电路制造用 300mm 单晶硅棒晶体生长研发与先进制造项目”拉晶产线建设和“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”切磨抛产线建设两部分，其中，后者为公司向特定对象发行股票募集资金的募投项目之一（同步履行募投项目实施主体变更决策程序）。项目建成后，将新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能，公司集成电路用 300mm 半导体硅片总产能达到 60 万片/月，进一步夯实业务基础、提高市场占有率。

#### 【晶丰明源 688368.SH】

公司于 2022 年 5 月 26 日发布《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》。该激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。该激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 23.00 万股。该激励计划首次授予的激励对象共计 88 人，占公司截止 2021 年 12 月 31 日员工总数 427 人的 20.61%。包括公司公告该激励计划时在公司任职的中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员。该激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 20.00 元。本激励计划在 2022 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。对于首次授予的限制性股票以及在 2022 年 10 月 31 日（含）前授予的预留限制性股票，业绩考核目标为：2022 年 DC/DC 产品线销售额不低于 0.05 亿元；2023 年 DC/DC 产品线销售额不低于 0.40 亿元；2024 年 DC/DC 产品线销售额不低于 1.50 亿元；2025 年 DC/DC 产品

线销售额不低于 3.50 亿元。对于在 2022 年 10 月 31 日（不含）后授予的预留限制性股票，业绩考核目标为：2023 年 DC/DC 产品线销售额不低于 0.40 亿元；2024 年 DC/DC 产品线销售额不低于 1.50 亿元；2025 年 DC/DC 产品线销售额不低于 3.50 亿元。

#### 【江丰电子 300666.SZ】

公司于 5 月 27 日发布《关于对外投资创业投资基金的进展公告》。公告显示，该项投资基本情况为公司以自有资金参与苏州顺融投资管理有限公司发起设立的投资基金苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）。安芯同盈基金初始规模为 7,010 万元人民币，普通合伙人及基金管理人为苏州顺融。公司作为有限合伙人认缴 1,000 万元人民币。近日，安芯同盈进行了如下变更：1.执行事务合伙人苏州顺融退伙；2.新增合伙人苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安洁私募”），对安芯同盈认缴出资额 10 万元人民币；3.新增合伙自然人艾竹轩，对安芯同盈认缴出资额 250 万元人民币；4.执行事务合伙人由苏州顺融变更为安洁私募；5.安芯同盈认缴金额由 7,010 万元人民币变更为 7,260 万元人民币。目前，安芯同盈完成了上述工商变更登记手续并取得了由苏州市吴中区行政审批局换发的营业执照。

#### 【上海新阳 300236.SZ】

公司于 2022 年 5 月 27 日发布《关于对外投资创业投资基金的进展公告》。公告显示，该项投资基本情况为公司以自有资金参与苏州顺融投资管理有限公司发起设立的投资基金，基金名称为苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙），安芯同盈基金初始募集规模 7,010 万元，普通合伙人及基金管理人为苏州顺融。公司认缴人民币 2,000 万元作为有限合伙人。近日，安芯同盈进行了如下变更：1.执行事务合伙人苏州顺融退伙；2.新增合伙人苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安洁私募”），对安芯同盈认缴出资额 10 万元人民币；3.新增合伙自然人艾竹轩，对安芯同盈认缴出资额 250 万元人民币；4.执行事务合伙人由苏州顺融变更为安洁私募；5.安芯同盈认缴金额由 7,010 万元人民币变更为 7,260 万元人民币。目前，安芯同盈完成了上述工商变更登记手续并取得了由苏州市吴中区行政审批局换发的营业执照。

## 4. 半导体重点新闻

**苹果 A16 芯片传仍采用台积电 5 纳米、M2 芯片改采用 3 纳米。** 苹果新一代 iPhone 的 A16 芯片，传将采用与 iPhone13 的 A15 芯片相同的台积电 5 纳米制程，但苹果为新一代 Mac 设计的 M2 芯片则将跳过 4 纳米，直接采用 3 纳米制程，而且爆料者 ShrimpApplePro 指称，苹果正在开发 M1 芯片的终极版本，A16 芯片仍将维持台积电的 5 纳米制程，就像 A14 芯片、A15 芯片和 M1 芯片一样，但会是更先进的 N5P 制程，这代表 CPU、GPU 和内存性能都会小幅提升，至于 N4P 则是 A16 芯片的强化型第三代版本。（中国半导体行业协会）

**晶圆需求持续成长，联电扩增海外产能。** 近日，联电在股东会上公布了其 2021 年的资本支出，达到了 80 亿美元。目前，联电南科 P5 厂扩建的 1 万片 28 纳米产能已经在今年第二季度开始量产。此外，联电将投资 50 亿美元在新加坡新建一座晶圆厂，预计将于 2024 年底开始生产。而且，将与日本电装合作，在联电子公司 USJC 的 12 英寸晶圆厂内合作生产车用功率半导体。联电在股东会公布了，其 2021 年全年销售额达到了约 73.5 亿美元，净利润约为 19.2 亿美元，共出货 990 万片 8 英寸晶圆，同比增长 10.6%。（中国半导体行业协会）

**斥资 3000 亿新台，南亚科 12 英寸新厂即将动土。** 近日，台塑集团旗下 DRAM 大厂南亚科发布媒体邀请函，表明南林科技园区新建双层无尘室 12 英寸厂计划将于 6 月 23 日举行动土典礼。据悉，此举是台塑集团投资 DRAM 存储器、摆脱科技束缚的关键举措。公开资料显示，台塑集团半导体事业布局广，除了南亚科之外，还有上游硅晶圆厂台胜科、载板厂南电、后段封测厂福懋科，发挥上下游垂直整合综效。南亚科则专注利基型

存储芯片。此前南亚科从 40 纳米到 20 纳米，每年需要向美光科技支付大量专利授权费。近年来积极投入自主研发，2020 年初开发出 10 纳米级 DRAM 新型存储器技术，同时确立下世代 10 纳米 DRAM 将采用自主研发技术，不再走授权模式。（中国半导体行业协会）

**供应链中断+新冠疫情导致全球光伏行业停工时间增加 95%！**美国保险资产管理商 GCubeInsurance 公司日前发布了其最新的市场洞察报告，其名称为“另一天供应：衡量可再生能源供应链挑战的保险影响”。根据这份报告，新冠疫情的爆发和随后带来的供应链中断使全球光伏行业在 2021 年的平均停工天数与 2016 年相比增加了 38%，与 2019 年至 2020 年的停工天数相比增加了 10%以上。全球光伏行业见证了这种中断带来的严重影响，平均停工天数增加了 95%。（中国半导体行业协会）

**消息称 NOR 闪存价格将在 2022 年下半年呈下降趋势。**5 月 25 日，据 DIGITIMES 报道，业内人士透露，NOR 闪存合同价格在 2022 年下半年可能会下降趋势。其中，低密度芯片的价格在第二季度已经开始下降。消息人士称，最近手机、个人电脑和消费电子产品的需求放缓，导致今年下半年的需求前景不确定，下游设备供应商面临越来越大的去库存压力。有关第三季度 NOR 闪存合约价格的谈判尚未最后敲定。芯片供应商打算将报价降低 3%，而品牌设备供应商的订单削减可能会给买家更多的议价能力。（中国半导体行业协会）

**投资 122 亿欧元，西班牙大力推进半导体产业发展。**近日，据国外媒体报道，西班牙政府进一步完善了大力推进半导体产业发展的计划，在上月宣布的初始投资基础上再增加 12 亿欧元，加上此前 110 亿欧元的投资承诺，合计达 122 亿欧元。据了解，其中 93 亿欧元将用于资助国内尖端（5nm 以下）和中端（5nm 以上）半导体生产厂的建设，11 亿欧元将用于研发，13 亿欧元用于芯片设计，目标是到 2027 年完成投资，这项计划来源主要是欧盟提供的大流行病救济资金。（中国半导体行业协会）

**美商务部长：美精密芯片 7 成中国台湾制，要赶快通过芯片法案。**据 CNBC 报导，美国商务部长雷蒙多 25 日在瑞士达沃斯世界经济论坛上接受媒体采访时表示，美国最精密芯片高达 70%皆产自中国台湾。美国的全球半导体产能占比逐年下降，2020 年已降至 12%左右。中国台湾是美国的主要芯片进口来源地，台积电是主要代工企业。雷蒙多呼吁国会通过美国芯片制造法案，“让企业在美国本土制造芯片，巩固我们的未来。”（中国半导体行业协会）

**消息称两家日本投资基金拟参与竞购东芝。**据报道，两位知情人士今日称，日本私募投资基金 JapanIndustrialPartners（JIP）和北极星资本集团（PolarisCapitalGroup）都在考虑参与对东芝公司的竞购。上个月，东芝成立了一个特别委员会，以探索各种战略选项，包括潜在的私有化交易。知情人士称，与全球主要私募股权公司相比，JIP 和北极星资本的规模要小得多，这意味着这两家公司都需要与其他公司合作，才能成功竞购东芝。（中国半导体行业协会）

**SEMI：2024 年底 8 英寸产能将达每月 690 万片新高。**随着成熟制程需求持续攀升，SEMI 最新数据显示，2020 年初至 2024 年底，全球半导体制造商 8 英寸产能有望提升 120 万片，增幅达 21%，届时将达到每月 690 万片的历史新高。SEMI 指出，今年 8 英寸产能中国大陆占比仍然为最高，为 21%，其次为日本的 16%、中国台湾和欧洲/中东地区分别各占 15%。去年 8 英寸厂设备支出攀升至 53 亿美元，随着全球代工厂为克服芯片短缺持续保持高水平产能利用率，扩产需求使得今年 8 英寸厂设备支出仍将达到 49 亿美元。（中国半导体行业协会）

**系统厂商涌入芯片设计业，短期劳动力供需紧张难解。**随着互联网、汽车等行业厂商跨界半导体，开出丰厚待遇招募人才，人力资源问题日益引发业内关注。根据 SEMI 预测，未来数年全球将有 90 家新的晶圆制造厂投入运营，在美国本土的新工厂就需要总计 4 到 5 万名新员工填充生产线上各个岗位，连同设计、销售、封装等其他职位，对人力需求巨大。SEMI 表示，其 450 个美国会员机构在最近 12 个月录得 8 万多个空缺。（中国半导体行业协会）

**应材第一/ASML 第二，全球半导体设备市场大者恒大。**根据外媒统计，2021 年全球前 20 大半导体设备供应商，应用材料仍居第一，营收金额达到 242 亿美元，至于独揽全球极紫外光曝光设备(EUV)的 ASML 则是排名第二，营收金额 211 亿美元。之后排行前五名的全球半导体设备供应商依序是东京威力科创（171 亿美元）、科林研发（165 亿美元）、科磊（82 亿美元）。其中，第四名的科林研发营收是第五名科磊的两倍，显示半导体设备市场大者恒大的特性。（中国半导体行业协会）

**韩研究所：韩国 NAND 技术领先中国 2 年，DRAM 领先 5 年。**根据韩国进出口银行海外经济研究所（OERI）推算，韩国和中国在存储芯片领域的技术差距为：DRAM5 年，NAND2 年。据 BusinessKorea 报道，该研究院透露，中国 DRAM 制造企业长鑫存储今年将推进第二代 10nm（1y 或 16nm 至 17nm）DRAM 的量产。三星电子等韩国企业计划在今年年末或明年批量生产第 5 代 10nm(1b 或 12nm-13nm) DRAM。考虑到每一代的技术差距为 2 年-2 年半，两国之间的技术差距超过 5 年。（中国半导体行业协会）

**Meta 元宇宙硬件将使用博通芯片，年规模超 10 亿美元。**据报道，摩根大通（J.P.Morgan）分析师今日表示，Facebook 母公司 MetaPlatforms 将使用博通公司（Broadcom）的定制芯片来生产其“元宇宙”硬件。这意味着，MetaPlatforms 将成为博通的“下一个十亿美元”ASIC 芯片客户。摩根大通称，得益于博通与 Meta 的交易，以及与 Alphabet 和微软的合作伙伴关系，ASIC（专用集成电路）芯片今年将为博通带来 20 亿美元至 25 亿美元的收入。（中国半导体行业协会）

**明年仍芯片短缺，美商务部长：台积电与中国台湾是重要伙伴。**美国商务部长雷蒙多（GinaRaimondo）5 月 31 日在一场电话简报会表示，全球芯片短缺可能延续到明年，甚至到后年年初以后才有机会缓解，她呼吁国会尽速通过补贴半导体产业的法案，否则这些芯片大厂恐外流，对美国不利。此外，雷蒙多表示，中国台湾是美国重要伙伴，尤其是在半导体制造领域有台积电，商务部与中国台湾方面也有科技贸易暨投资合作架构（TTIC），美台将持续深化经济关系，美国正就科技贸易和投资与中国台湾展开积极对话，美国将持续寻求与中国台湾合作。（中国半导体行业协会）

## 5. 风险提示：

宏观不确定性，疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com